

江苏长电科技股份有限公司

2025 年度、2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会 记录

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日（星期四）10:00-11:30 通过进门财经电话会议（易董价值在线平台同步转播）、上证路演中心网络文字互动召开了 2025 年度、2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司董事/首席执行长（CEO）郑力先生、独立董事董斌先生、董事/首席财务长梁征先生、董事会秘书袁燕女士、副总裁吴宏鲲先生等相关人员就公司 2025 年全年及 2026 年第一季度经营成果及财务具体情况和 2025 年分红与市值管理制度执行情况与投资者进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次会议投资者重点关注的问题及公司回复情况如下：

1. 2026 年资本开支增长较大，投向方向主要有哪些？

2026 年固定资产投资预算约 100 亿元，较去年预算大幅增加，彰显了公司坚定把握半导体行业战略性机遇的决心和执行力。投入的规模和水平也处于国内封测行业最高水平。除维持正常经常性资本开支外，主要投向两个方向：一是继续加大研发投入力度，促进技术成果转化；二是产能扩充，重点在先进封装产线建设，同时根据客户需求进行主流封装产能扩张。应用领域集中在运算及汽车电子等战略方向，持续优化业务和产品结构。

2. 2026 年各下游增速情况如何，尤其是运算电子的指引和展望？

运算电子方面，2026 年公司 2.5D 产品加速量产导入，客户需求持续强劲，与之匹配高密度存储及高密度电源管理模块需求自二季度起、特别是下半年迎来爆发式增长，与主流封装厂商趋势研判一致。

汽车电子方面，临港工厂客户导入加速产能爬坡，公司将推动临港与各工厂在汽车电子领域协同布局。随着越来越多国内外头部客户优质项目于海内外工厂陆续落地，汽车电子智能化发展前景可期。

工业领域，国际模拟巨头业绩超预期，标志行业整体及消费模拟领域迎来拐点。功率半导体、信号链、传感器等核心品类呈现量价齐升态势，工业领域复苏动能强劲。

通讯类方面，受业务结构调整及行业周期影响，该板块自去年至今年一季度承压。预计自二季度起逐步度过调整期，伴随智能化应用场景拓展，叠加下半年客户新品发布及季节性备货，通讯业务将明显回升。

3. 公司年报中提到光电合封（CPO）已有布局并实现客户样品交付，能否展开讲一下目前公司在 EIC/PIC 堆叠的技术能力，以及未来订单放量的节奏？

公司自两三年前起与多家头部客户开展深度联合研发，近期在产品交付上取得关键进展。EIC 与 PIC 堆叠技术已完成储备，量产安排将视客户进度适时推进。当前，客户需求已从单一的光、电芯片封装，升级为将 EIC 与 PIC 堆叠形成的光引擎，通过 2.5D 技术与传输、交换芯片集成于 Chiplet 平台，并与存储芯片融合为整体的异质异构封装方案，该方案被视为未来数据中心的核心技术路径。

过去一年，下游客户在 NPO、XPO 及 CPO 与算力芯片的结合方案上持续探索取舍。近半年来，客户端及主流封测厂商包括公司自身在内，在提升 CPO 可靠性、优化成本结构方面均取得显著突破。面向未来，公司将持续推动 EIC 与 PIC 光引擎的规模化量产与业务拓展；同时，加速开发基于硅中介层与硅光芯片的复合中介层方案，实现光引擎与计算、交换、存储芯片的整体异质异构集成，推动 CPO 方案在数据中心加速落地。公司将持续加大研发投入，深度协同国际与国内客户，加快技术成果向商业化方案转化。多家头部客户的同步储备，为先进封装业务的长期增长注入强劲动能。

4. 长电汽车电子去年通线、产能开始爬坡，也有国内和国外的客户，公司对何时盈利有预期吗？

临港工厂今年 3 月正式投产，目前处于爬坡阶段，正加速设备引进和到位。公司成立多个专项小组加强与客户沟通和产品导入。重点主流汽车客户及具身机器人方面新客户均在积极保持研发及产品导入联系。预计经历短期爬坡期后，从下半年三四季度开始产出规模逐步提升。车规产品导入期较其他产线更长，属正

常现象。公司内部制定了进取的目标，希望压缩产品导入期，尽快满足新能源汽车对芯片持续攀升的需求。

5. 看到公司长电微开始贡献收入，同时公司的资本支出指引在 2026 年也保持强劲，想问下，长电微在未来 1-2 年，可以预期一个什么样的收入机会？

去年长电微刚投产，已贡献一定收入。从当前客户项目储备和量产扩大趋势来看，进展相当顺利。客户导入项目非常丰富，现场工程负荷饱满，未来一两年，公司对长电微 2.5D 业务发展充满信心，正紧锣密鼓推动各客户项目上量。

该业务达到几十亿规模在我们的规划之中。我们相信能按计划顺利推进，供应链和产业链的支持也日益顺畅。从供应商到行业层面，我们都观察到许多积极信号，这进一步增强了我们的信心。我们对相关业务尽快达到几十亿规模非常有信心。

6. 公司在新加坡搞了先进封装的活动。如何期待公司的先进封装业务在海外的机会和挑战，哪些领域/产品会更有机会落地？海外先进封装业务的毛利率会明显好于国内吗？

海外市场先进封装需求旺盛，整体呈现供不应求态势，但长电在海外的 development 环境与国内存在明显差异。国内市场机遇远大于挑战，发展较为顺畅；海外市场则呈现不同的发展逻辑，海外头部晶圆厂正积极推动 2.5D 及更先进方案，而过去几年受贸易保护政策影响，长电海外工厂在参与相关市场供应方面受到一定限制，当前这一情况正发生积极变化。一方面，公司在过去一两年持续布局先进封装技术及生态链，能力储备日益完善；另一方面，产业层面出现两个重要变化。

其一，海外头部晶圆厂正将更多资源投向面向未来的 3D 封装以解决摩尔定律核心瓶颈，其 2.5D 项目开始向外溢出，在海外客户支持下相关项目向公司转移，项目数量和内容正逐步显现，公司在 2.5D 领域承接此类溢出需求正成为日益明显的趋势。其二，海外先进封装需求正向端侧延伸，高端 PC 及手机 AI 等领域新项目持续涌现，这与以往智能手机及高端 PC 芯片的传统需求形态已显著不同，而端侧 AI 正是公司传统优势所在。

综上，公司海外先进封装业务呈现两方面的变化，一是传统业务向 AI 终端

化升级带来的新项目机遇，二是海外晶圆厂项目溢出的产业大趋势，同时贸易政策方面的空间也在逐步拓展。从毛利率角度看，海外同类业务未必高于国内，但随着消费类电子向 AI 终端化演进，海外业务整体毛利水平无疑将获得提升。

7. 针对近年来新建及扩建产能，目前整体爬坡进展如何？公司如何平衡短期利用率与中长期需求之间的关系？

新建产能整体围绕人工智能为核心的产业需求，重点服务算力、存力、电力等维度对先进封装的要求。长电科技布局的先进封装既包括市场关注度较高的 2.5D 及 3D 晶圆级封装，也涵盖以异质异构集成为核心的高密度 3D 系统级封装，这正是公司作为综合性先进封装企业的核心优势所在。产能爬坡方面，公司正坚决推动 2.5D 产能建设，并同步推进 3D 技术开发及相关产能布局，汽车电子领域亦持续高水平投入且爬坡进展符合预期。

公司正视短期利用率与长期需求之间的平衡，这正是长电作为具备规模优势且背靠强大资金支持的综合性企业的战略定力所在。当前公司凭借现有业务复苏稳步提升利润及利润率，同时即便需要适度牺牲部分短期利润、调整非先进产能，也要坚决为算力、存力、电力等方向腾出空间、加大投入。目前公司资金充裕，融资渠道畅通，大股东亦给予坚定支持。

在保持财务健康的前提下，公司将以高强度的研发和产能投入进行战略性业务取舍，主动承担短期利润承压和转型期调整的需要，坚决全面聚焦先进封装并推动主流封装先进化。通过平衡好上述因素，加速客户导入和上量，缩短技术成果转化周期，这是公司当前的基本考量与执行方向。

8. 运算电子业务近年来增长较快，公司如何看待其中 AI 相关需求的驱动作用？整体占比及变化趋势如何？

运算类发展尚处初期，增长空间广阔，近期动能将逐步释放。核心驱动力来自 AI，随着 token（词元）消耗量呈倍数级增长，算力相关先进封装需求日益强劲；同时，AI 从训练向推理演进，除算力外，对高性能后道封装也提出更高要求。

存储是公司传统优势领域，与国际巨头战略合作的闪存产品正发挥关键作用，凭借大容量优势在近算存储方向迎来更好发展。此外，AI 驱动下电力消耗问题日

益突出，国际及国内头部客户对 GPU 集中供电的高密度电源管理需求非常强劲。算力、存储、电力三大方向共同构成公司未来发展的首要动力。

9. 目前公司产线整体的稼动率与价格情况如何？是否可以分享一下今年的稼动率展望和价格趋势？

一季度国内市场呈现淡季不淡特点，国内主要工厂订单饱满，处于不断投产、增加产能状态。海外工厂从去年开始主动进行业务结构调整，目前已有新订单和产品逐步安排，通讯市场有复苏迹象。全年稼动率努力做到不断提升、稳中有升。一季度整体产能利用率已超过 80%，后续有新工厂和产能逐步释放，努力推动整体稼动率提升，加强与市场和客户链接，优化订单和排产。

价格方面，从去年开始在原材料价格上涨趋势下，联动机制已逐步成熟，得到越来越多客户理解和积极响应。在产能供不应求、产能相对紧缺情况下，产线资源宝贵，公司不断优选客户、优化产品结构，提升单位价格。

10. 去年长电韩国的运营情况如何，能否对今年也做个展望？

长电在韩国目前运营 SCK 与 JSCK 两个工厂。SCK 主要面向 SoC 及 2.5D 大颗 FCBGA 产品，进展较为顺利，今年以来不断有新产品导入，包括头部晶圆厂溢出的先进封装项目亦在持续推进。JSCK（长电韩国）则聚焦高密度异质异构集成，以高密度系统级封装为主。

JSCK 在 2025 年前长期以通信类产品为主。自去年下半年起，我们主动进行业务取舍与“腾笼换鸟”的安排。一方面推动智能手机通讯类产品继续发展，射频、WiFi 等通信设备类产品向更高密度演进；另一方面借助技术底座，腾挪资源向 AI 相关应用转型。去年及今年一季度虽按计划推进调整，财务表现暂不理想，但我们本着不破不立、勇于取舍的理念坚定推进，目前调整已接近尾声。

通过此次调整，JSCK 将更好地把握面向数据中心相关产品需求，特别是在供电类高密度系统级封装领域充分发挥专长。存储高密度模组亦是其未来，凭借其技术优势，可重点发力方向，与 AI 浪潮更加紧密结合。自二季度起新产品已逐步上量，进展超出预期。未来几个季度，韩国工厂发展非常值得期待。

11. 请问公司目前在存储封装的扩产计划和核心优势，以及在存储业务中的份额、市场卡位等？

存储是公司重点推动的核心应用领域之一，前几年已完成一系列战略布局。本轮存储上量势头凶猛，预计持续时间较长，当前行业主要呈现两方面特征。

面向国际客户，存储价格持续上涨，客户尚处于享受价格红利阶段，提高产出意愿不高，短期对封装产能的需求变化不大。但我们判断，随着价格逐步趋稳，国际客户对封装的需求将显著增加，封装产能扩充势在必行。公司正密切观察时机，并与国际客户积极探讨，力求精准把握资本投入周期。面向国内市场，当前正是客户提升市场份额、大力扩张的时期。公司将充分发挥国内工厂在存储领域多年的技术积累，积极与客户协同扩充产能，相关业务收入将逐步释放。同时，公司正加大高端技术研发投入，预计未来两三年将取得积极成果。

长电科技并非仅聚焦 2.5D/3D 算力，而是将存储、电源管理等能力形成组合拳，为客户提供综合先进封装解决方案。

12. 我们同时处在产品结构优化叠加新工厂爬坡&资本开支折旧增加的时期，是否可以请领导展望一下未来毛利率的趋势？

毛利率驱动因素处于有利且可预期状态，一是维持高产能利用率，显现规模效应，产能布局不断调整优化，增加先进封装高附加值产品占比；二是大宗商品持续上涨环境下，价格联动机制越来越多得到客户响应，落地进展良好；三是成本管控持续有效，如金转铜替代方案落地、智能制造和精益生产阶段性成果落地，通过自动化水平提高来提升生产效率、降低成本。这几方面因素推动整体毛利率稳中有升，长期有利因素更多。

新工厂处于爬坡期、新旧叠加转型阶段，短期毛利有承压。但爬坡期价格和毛利管控逻辑类似，希望通过加快产品导入、不断缩短导入期。整体毛利率从今年短期和未来看均相对乐观。

13. 请问目前新导入的高密度系统级封装新产品，是面向数据中心相关，还是端侧像智能眼镜这类的产品，也是海外客户为主？

除原有大客户面向通讯类的新品以外，也有面向数据中心相关的海内外客户

新产品。

14. 请问 SanDisk 是公司超过 10% 营收的大客户吗？

Sandisk 是公司紧密合作的客户之一。

15. 请问贵司江阴和临港两家新厂的产能爬坡情况？

尊敬的投资者您好，公司正加快推动长电微电子晶圆级微系统集成高端制造项目的产品上量，上海临港车规级芯片封测项目正式启用，多家国内外车载芯片客户的生产项目正在积极推进产品认证和量产导入工作。谢谢！

16. 请问公司目前 2.5D 在整个业务中占比多少？

尊敬的投资者，您好。公司资本开支力度和研发投入强度逐年显著提升，将支持未来几年相关产能和收入实现快速增长。感谢您的关注与支持！

风险提示：本次会议内容中涉及对行业前景的预测、公司发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应保持足够的风险意识，充分理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。